



主要特点

通道数目: 6

通带频率: 5.6 – 9.1 GHz

7.5 – 11.5 GHz

9.2 – 15.5 GHz

10.4 – 17.5 GHz

10.9 – 18.4 GHz

12.8 – 20.3 GHz

输入 P1dB: 22dBm

控制电压: 0 / +5 V

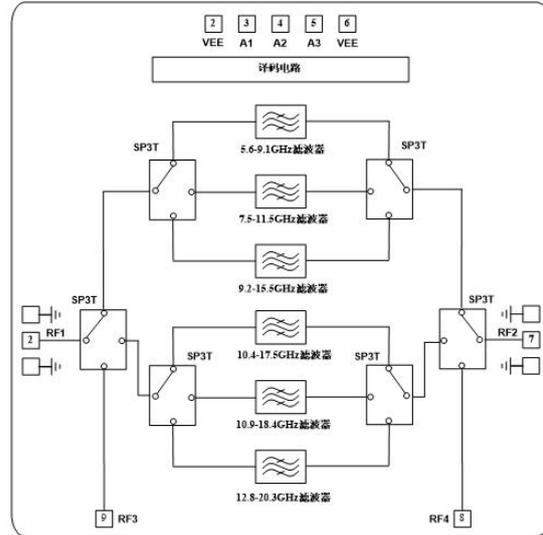
(“0”电平范围: 0~0.5V;

“1”电平范围: 3~5V)

供电: -5 V @ 12 mA

芯片尺寸: 4 × 3.5 × 0.1 mm³

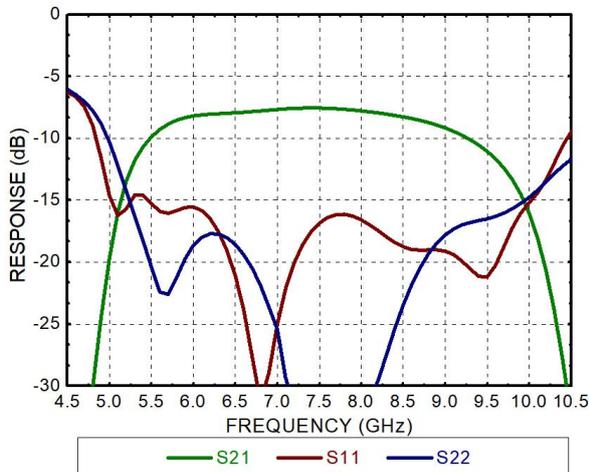
功能框图



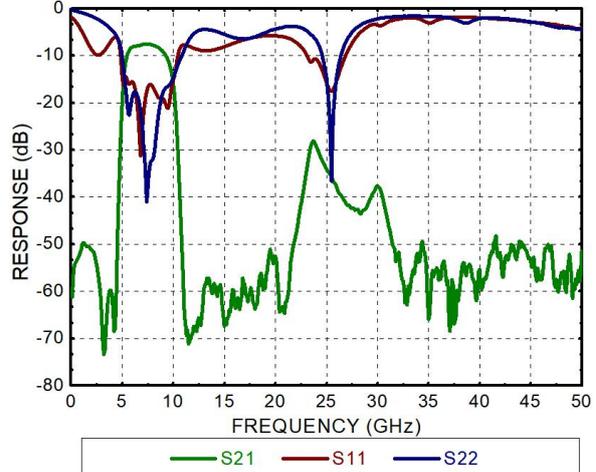
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	5.6-9.1GHz	7.5-11.5GHz	9.2-15.5GHz	10.4-17.5GHz	10.9-18.4GHz	12.8-20.3GHz	单位
插入损耗	8	8	8	8	8	8	dB
带内平坦度	±1	±1	±1	±1	±1	±1	dB
回波损耗	15	15	15	15	15	15	dB
带外抑制	40@4.6GHz 40@10.7GHz	40@6.3GHz 40@14GHz	40@7.9GHz 40@18.1GHz	40@8.9GHz 40@20.3GHz	40@9.5GHz 40@21.6GHz	40@11.2GHz 40@24.5GHz	dB

5.6-9.1GHz反射系数

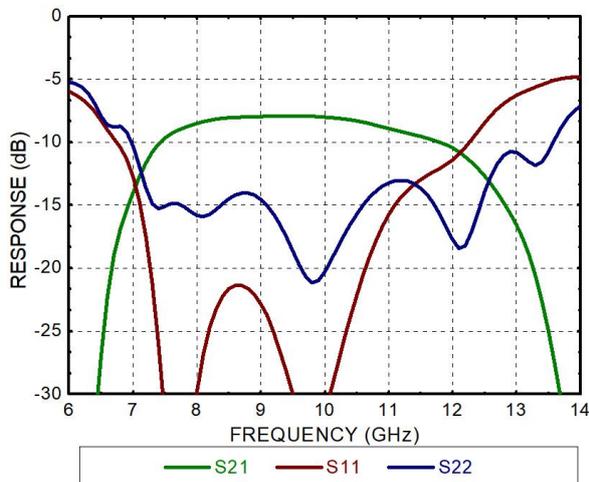


5.6-9.1GHz反射系数

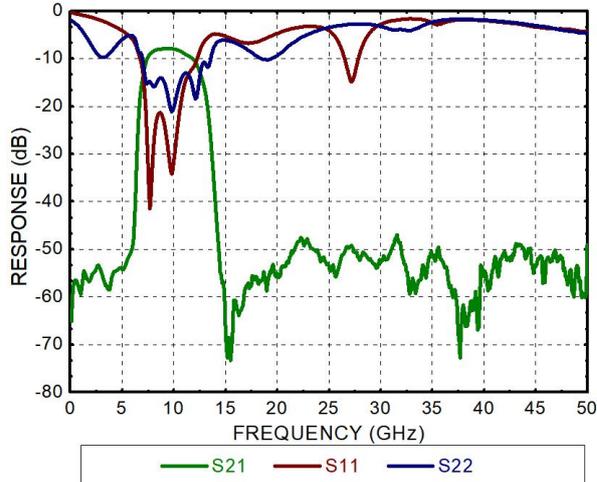




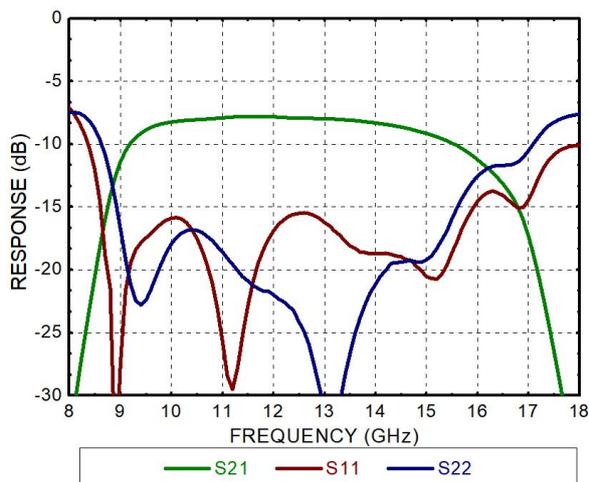
7. 5-11.5GHz反射系数



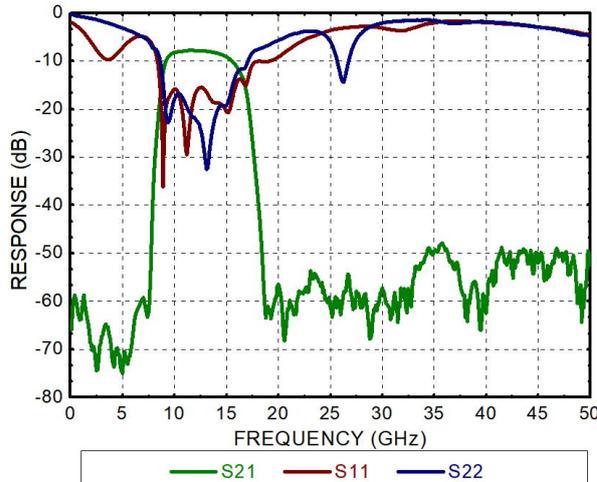
7. 5-11.5GHz反射系数



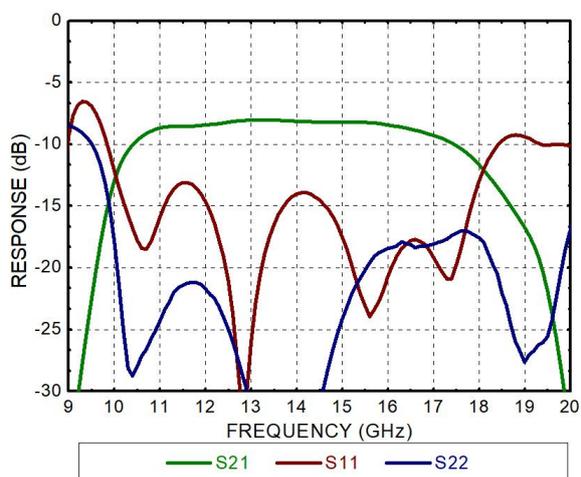
9. 2-15.5GHz反射系数



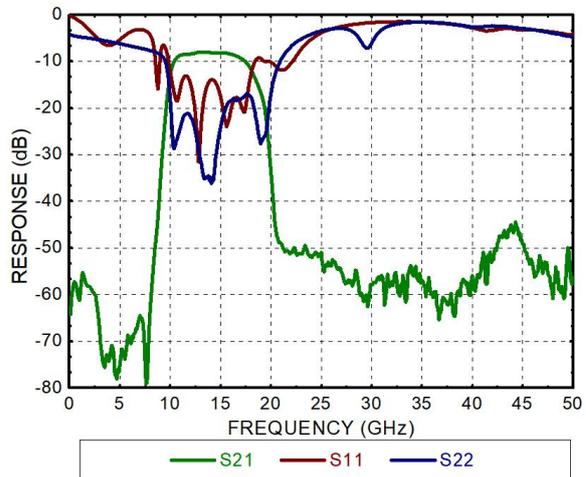
9. 2-15.5GHz反射系数



10. 4-17.5GHz反射系数

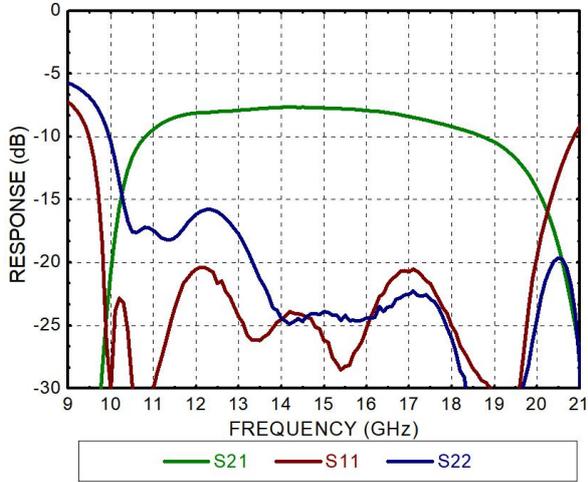


10. 4-17.5GHz反射系数

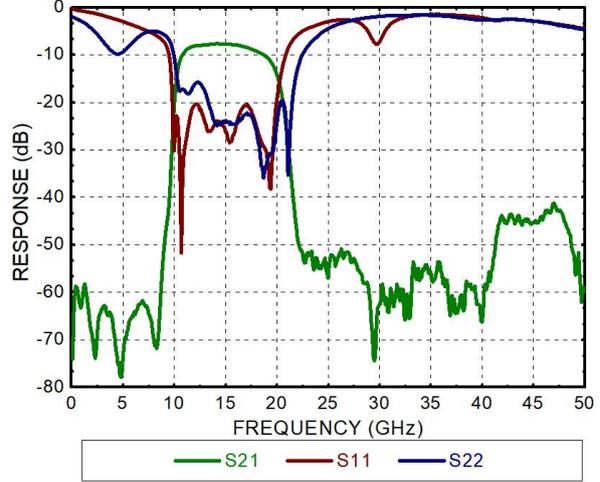




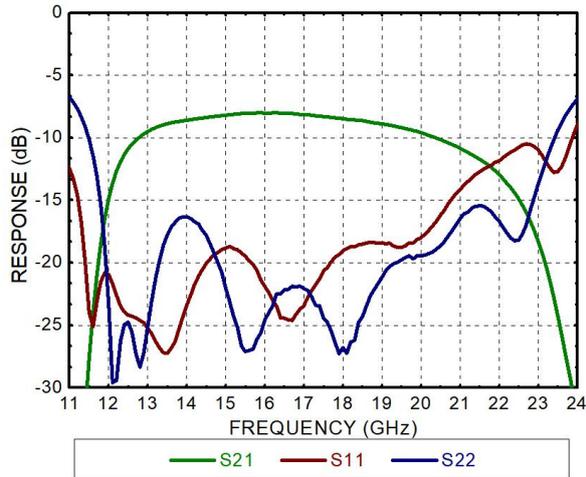
10. 9–18. 4GHz反射系数



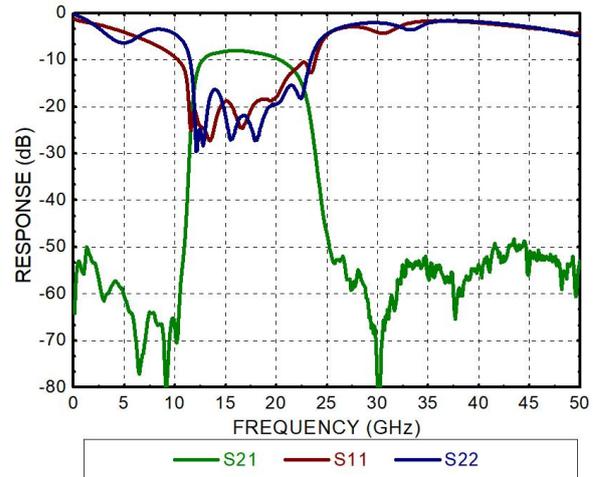
10. 9–18. 4GHz反射系数



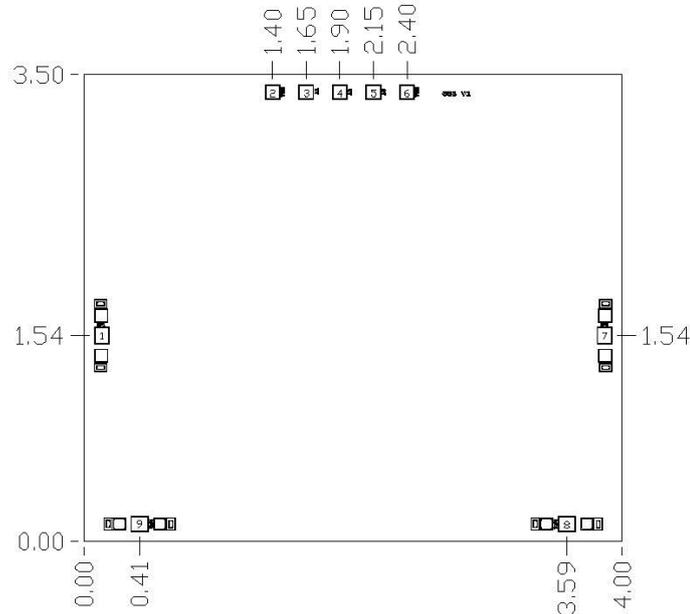
12. 8–20. 3GHz反射系数



12. 8–20. 3GHz反射系数



物理参数



焊盘描述

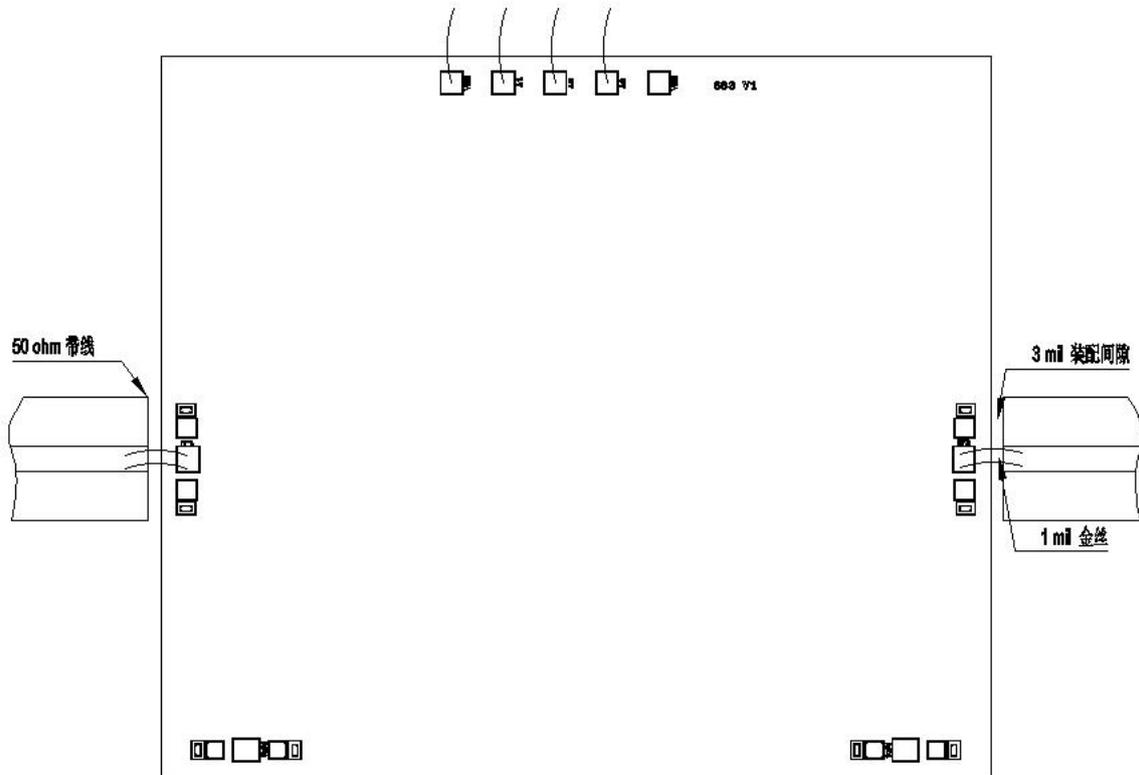
焊盘序号	功能	描述	焊盘尺寸
1、7	RF1, RF2	该焊盘是 RF 信号输入输出端, DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容	120 X 100um
2、6	VEE	该焊盘是直流电源输入端, 使用时任选一端接-5V 电压	100 X 100um
3-5	A1-A3	该系列焊盘为 0/+5V 控制电压输入端口, 控制关系见真值表	100 X 100um
8、9	RF3、RF4	该焊盘是芯片预留焊盘, 可与外部器件级联使用, DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容, 不进行使用时可空置	120 X 100um
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地	---

真值表

控制频带	A1	A2	A3
RF1-RF3/RF2-RF4	0	0	0
5.6~9.1GHz	1	0	0
7.5~11.5GHz	0	1	0
9.2~15.5GHz	1	1	0
10.4~17.5GHz	0	0	1
10.9~18.4GHz	1	0	1
12.8~20.3GHz	0	1	1
“0” 电平范围: 0~0.5V; “1” 电平范围: 3~5V			



装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 键合焊盘金属化: 金
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: -6 V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度: -55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$